

488696-2026 - Hange

lirimaa – Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Education Procurement Service (EPS)

E-posti aadress: info@educationprocurementservice.ie

Hankija õiguslik vorm: Avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Kirjeldus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Menetluse tunnus: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): South-East (IE052)

Riik: Iirimaa

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 4

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Kirjeldus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): South-East (IE052)

Riik: Iirimaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 48 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Hankedokumentidele internetiv lalt juurdep  su pakkuv organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Education Procurement Service (EPS)

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Kirjeldus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisemine tunnus: 2

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja t ppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Riik – jaotus (NUTS): South-East (IE052)

Riik: Iirimaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 48 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus k ibemaksuta: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics
Kirjeldus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisemine tunnus: 3

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): South-East (IE052)

Riik: Iirimaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 48 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Education Procurement Service (EPS)

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: Plasma Deposition ,PECVD

Kirjeldus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the

following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisemine tunnus: 4

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): South-East (IE052)

Riik: Iirimaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 48 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Education Procurement Service (EPS)

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Education Procurement Service (EPS)

Registreerimisnumber: IE 6609370 G

Postiaadress: Castletroy Limerick

Linn: Limerick

Sihtnumber: V94 DK53

Riik – jaotus (NUTS): Mid-West (IE051)

Riik: Iirimaa

E-posti aadress: info@educationprocurementservice.ie

Telefon: 000

Internetiaadress: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Hankija profiil: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: The High Court of Ireland
Registreerimisnumber: The High Court of Ireland
Osakond: The High Court of Ireland
Postiaadress: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Linn: Dublin
Sihtnumber: D07 WDX8
Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)
Riik: Iirimaa
E-posti aadress: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefon: +353 1 8886000

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: European Dynamics S.A.
Registreerimisnumber: 002024901000
Osakond: European Dynamics S.A.
Linn: Athens
Sihtnumber: 15125
Riik – jaotus (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Riik: Kreeka
E-posti aadress: eproc-esender@eurodyn.com
Telefon: +30 2108094500

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
:
46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01
Muudatuse peamine põhjus
:
Teave ajakohastatud

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 488696-2026

ELT S väljaande number: 134/2026

Avaldamise kuupäev: 15/07/2026